臻鼎科技控股
Zhen Ding Tech. Holding

# 臻鼎科技控股 (4958 TT)

# 2023年上半年法人說明會

2023年8月9日

# 免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

臻鼎科技控股
Zhen Ding Tech. Holding

# 簡報大綱

1. **2023年上半年度營運成果**
   王元生 財務長
2. **IC載板營運規劃與執行**
   李定轉 董事
3. **策略布局**
   沈慶芳 董事長兼總經理

臻鼎科技控股
Zhen Ding Tech. Holding

# 2023年上半年度營運成果

王元生 財務長

# 上半年營運成果摘要

1. **總體環境不佳、終端需求疲弱，導致產業產能過剩，面臨客戶降價壓力，在價量同時承壓下，致使上半年營收年減 19.5%。**

2. **公司看好未來產業趨勢，包含IC載板領域，持續投入研發與資本支出，上半年**
   - 研發費用 42.4億，較去年同期增加 7.4億，增長21% 。
   - 資本支出 147億，和去年同期約當。
   - 折舊攤銷 80億，較去年同期增加 10.5億，增長15% 。

3. **公司財務穩健**(截至2023年6月30日)
   - 淨現金水位 125億，較去年同期增加 70億。
   - 負債比率 43.9%，和去年同期約當。

# 半年度營運成果

單位: 新台幣佰萬元，除另予註明者外

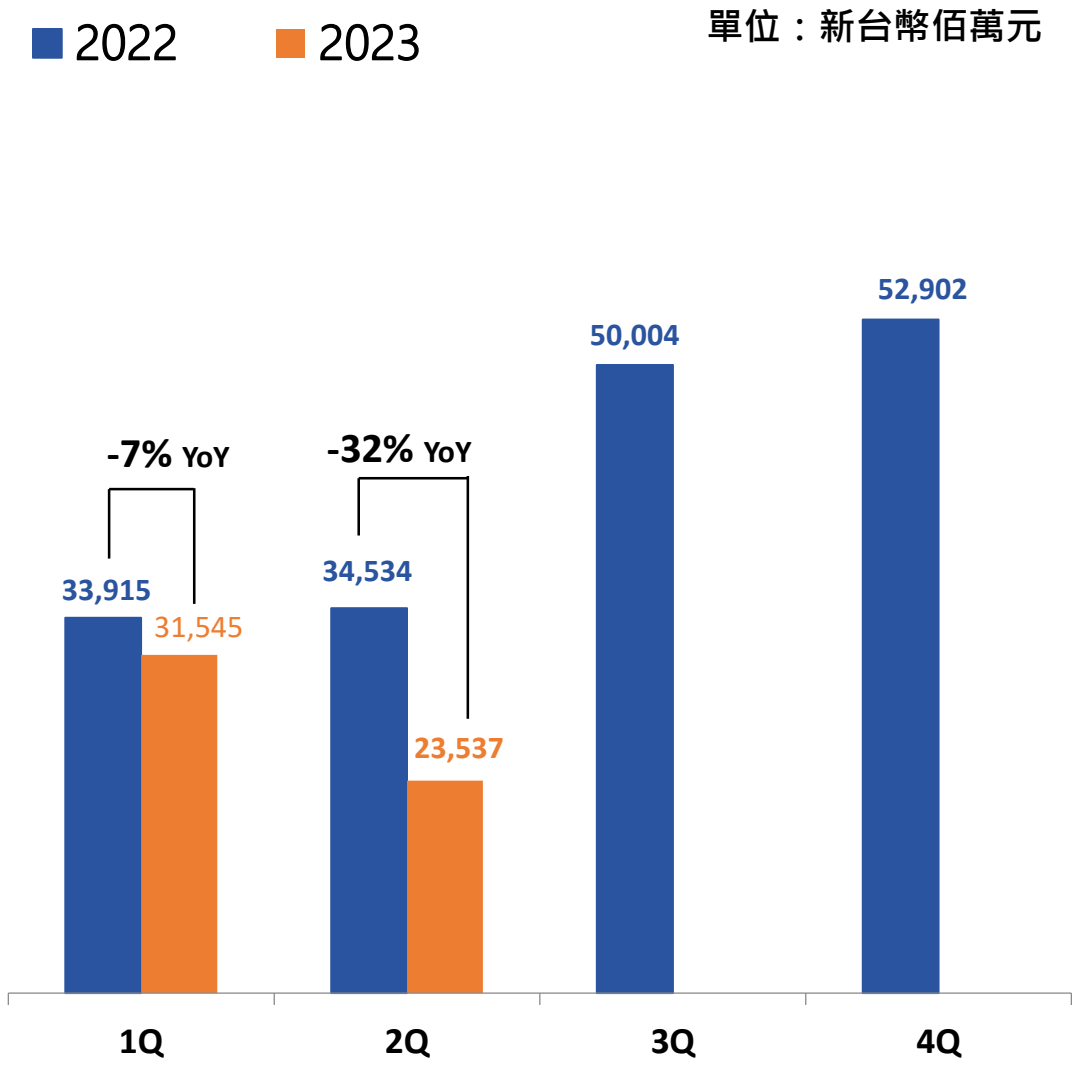
| | 1H23 | 1H22 | 年變化 (%) |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 55,082 | 68,450 | -19.5% |
| 營業毛利 | 7,198 | 12,990 | -44.6% |
| **營業毛利率** | **13.1%** | **19.0%** | **-5.9ppts** |
| 營業費用 | 7,867 | 7,303 | +7.7% |
| 營業利益 | (669) | 5,686 | |
| **營業利益率** | **-1.2%** | **8.3%** | **-9.5ppts** |
| 營業外收入及支出 | 1,075 | 1,651 | -34.9% |
| 本期淨利 | 1,013 | 6,506 | -84.4% |
| **淨利率** | **1.8%** | **9.5%** | **-7.7ppts** |
| 歸屬於母公司之淨利 | 414 | 4,507 | -90.8% |
| 每股盈餘 (新台幣元) (1) | **0.44** | **4.77** | |
| 營運活動之現金流入 | 15,216 | 21,443 | -29.0% |
| 資本支出 | 14,684 | 15,246 | -3.7% |
| 現金及約當現金(2) | 59,916 | 44,480 | +34.7% |
| 股東權益報酬率 (%) (3) | 1.6% | 11.2% | -9.6ppts |

附註：(1) 2023年上半年加權平均流通在外股數為944,956仟股。(2)現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。
(3) 股東權益報酬率為以母公司股東平均股權計算的年化數據。

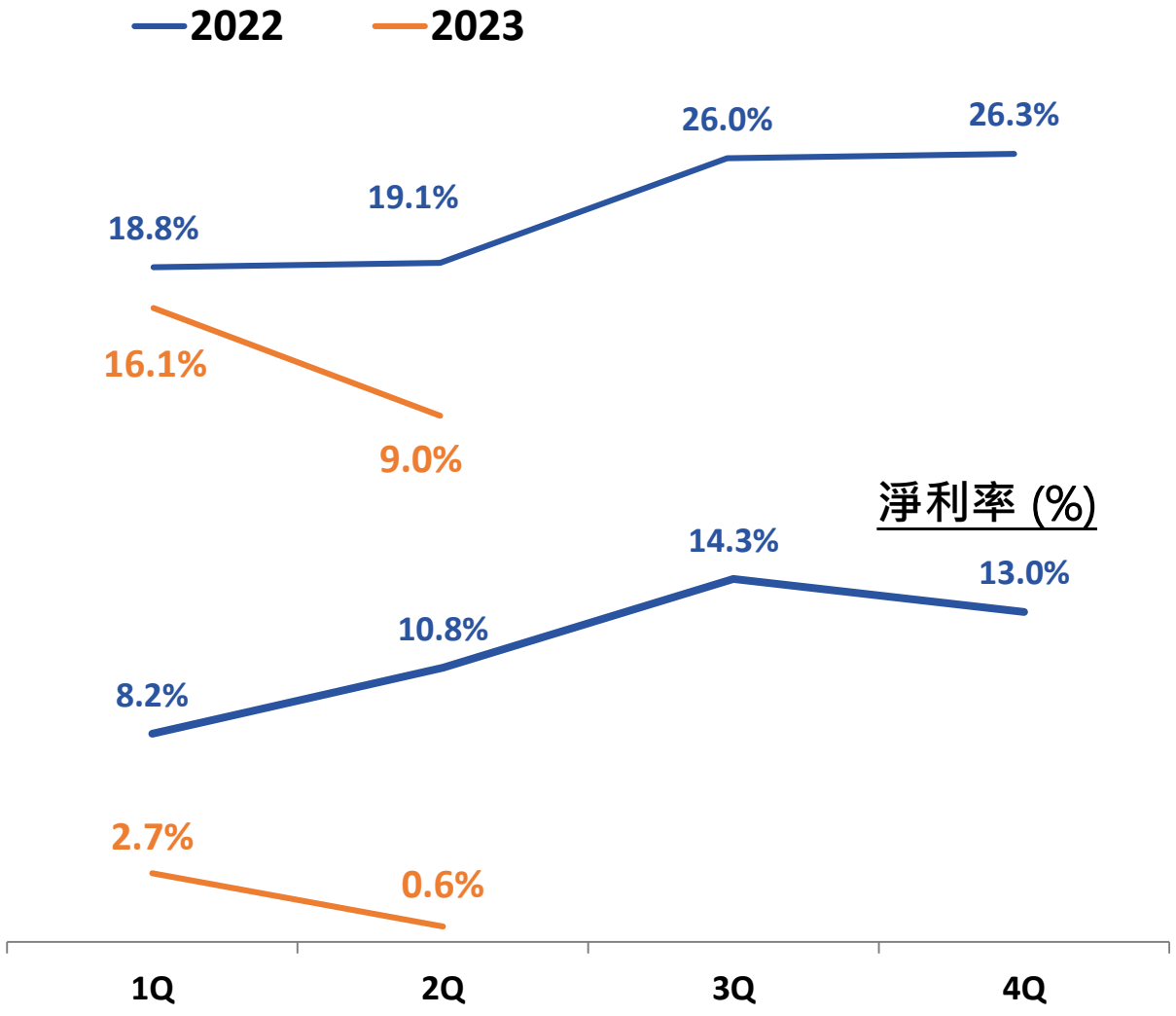
# 季度營運成果

## 營業收入

單位：新台幣佰萬元



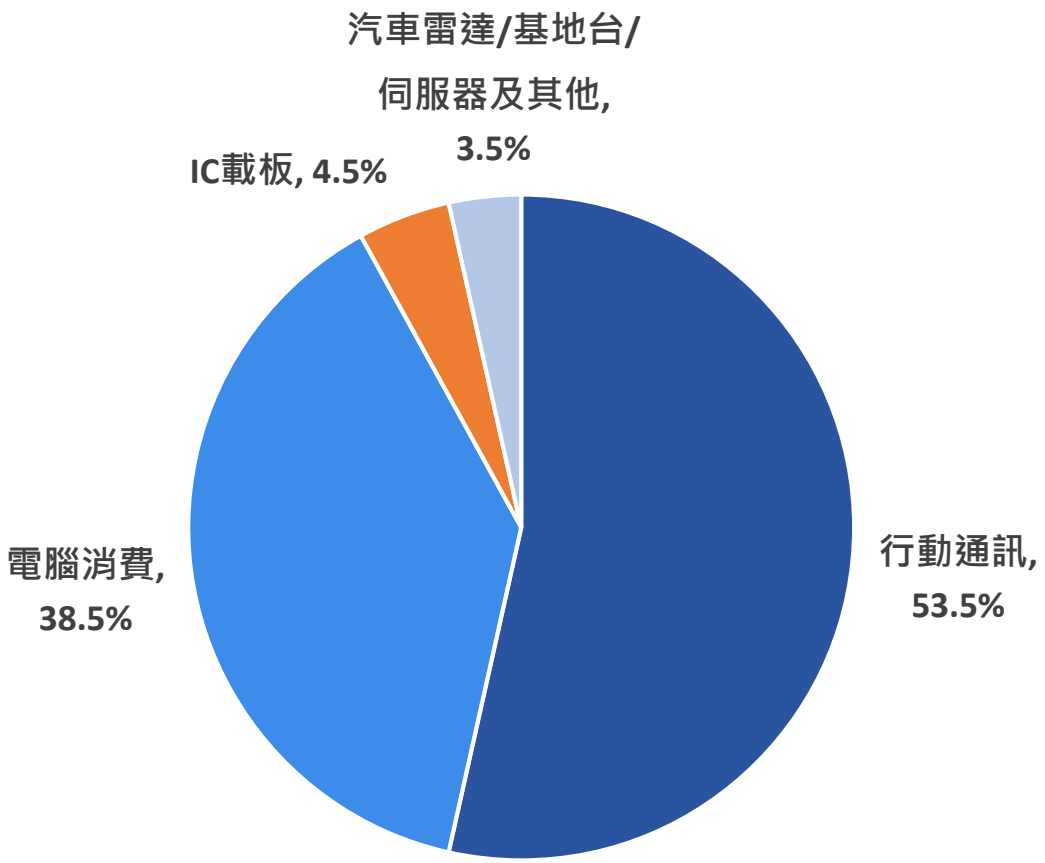

## 毛利率 (%)



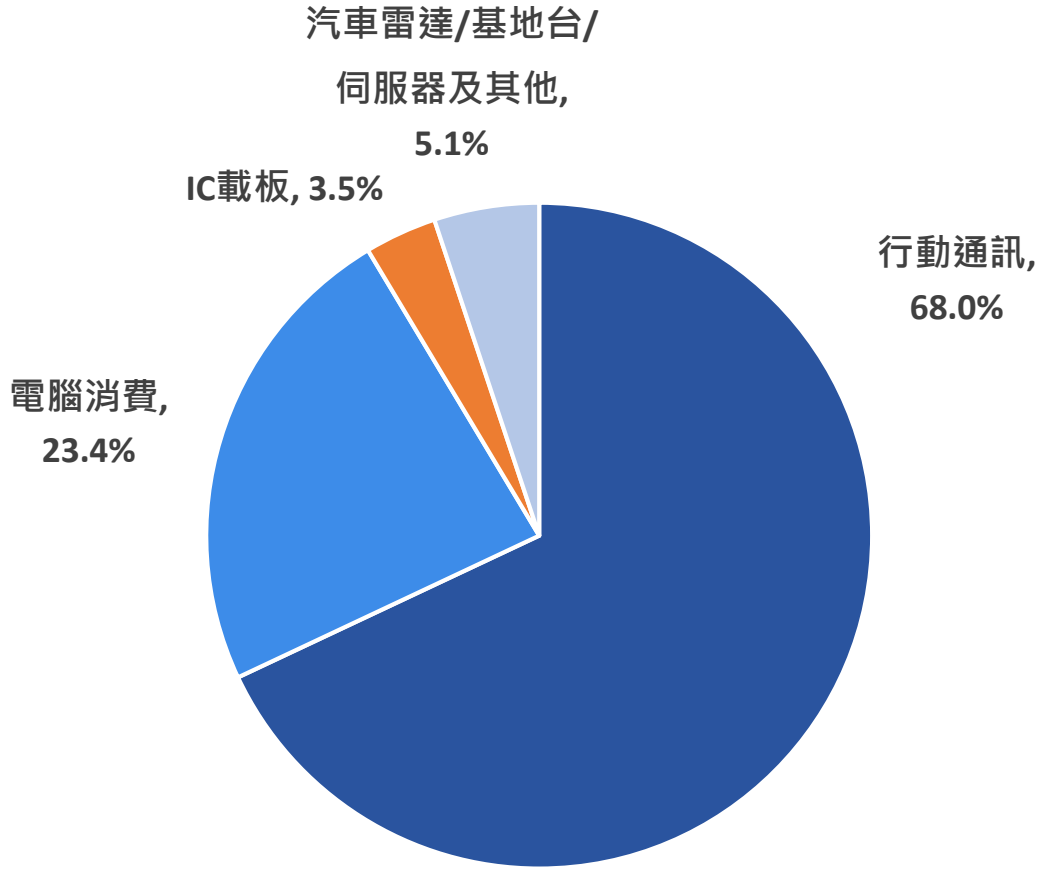

## 淨利率 (%)

# 銷售分析–產品應用別

## 1H2022 營收新台幣685億




## 1H2023 營收新台幣551億



# 資產負債表及重要財務比率

單位：新台幣佰萬元

| | 2023-6-30 | | 2022-6-30 | | 差異 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 現金及約當現金[2] | 59,916 | 26.8% | 44,480 | 21.5% | 15,436 | +5.3ppts |
| 應收款項 | 17,496 | 7.5% | 24,951 | 12.1% | (7,455) | -4.6ppts |
| 存貨 | 13,784 | 5.9% | 20,941 | 10.1% | (7,157) | -4.2ppts |
| 不動產、廠房及設備[3] | 108,559 | 48.5% | 96,597 | 46.7% | 11,962 | +1.8ppts |
| **資產總額** | **223,833** | **100.0%** | **206,793** | **100.0%** | **17,040** | |
| 借款 | 47,455 | 21.2% | 39,019 | 18.9% | 8,436 | +2.3ppts |
| 應付款項 | 35,325 | 15.8% | 37,136 | 18.0% | (1,811) | -2.2ppts |
| **負債總額** | **98,219** | **43.9%** | **88,242** | **42.7%** | **9,977** | |
| **股東權益總額** | **125,615** | **56.1%** | **118,551** | **57.3%** | | |
| **重要財務比率** | | | | | | |
| 平均收現日數(天) | 78 | | 83 | | (5) | |
| 平均銷貨日數(天) | 66 | | 67 | | (1) | |
| 流動比率(倍) | 1.30 | | 1.43 | | (0.13) | |
| 資產生產力(倍)[4] | 1.03 | | 1.50 | | (0.47) | |

附註：(1) 2023年6月30日流通在外股數為944,956仟股。(2) 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。
(3) 不動產、廠房及設備包含投資性不動產。(4) 資產生產力=年化營業收入淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。

# 歷年營運成果

單位：新台幣佰萬元

| 年度 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 44,280 | 55,369 | 64,483 | 75,954 | 85,738 | 82,393 | 109,238 | 117,913 | 120,068 | 131,279 | 155,022 | 171,356 |
| 營業毛利 | 6,993 | 10,775 | 11,894 | 14,323 | 16,427 | 12,542 | 17,833 | 26,061 | 27,222 | 26,584 | 30,537 | 39,888 |
| 本期淨利 | 2,356 | 4,056 | 5,471 | 6,735 | 7,731 | 3,456 | 6,772 | 11,536 | 12,402 | 11,508 | 13,694 | 20,535 |
| 母公司淨利 | 2,356 | 4,056 | 5,471 | 6,735 | 7,731 | 3,456 | 5,172 | 8,448 | 8,685 | 8,095 | 9,651 | 14,197 |
| 折舊及攤銷 | 3,008 | 3,375 | 3,742 | 4,293 | 4,850 | 5,295 | 5,679 | 6,820 | 7,955 | 8,405 | 11,875 | 14,638 |
| 每股盈餘 (元) | 3.30 | 5.49 | 7.41 | 9.12 | 9.80 | 4.29 | 6.43 | 10.50 | 9.93 | 8.90 | 10.21 | 15.02 |
| 每股股利 (元) | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 3.67 | 4.50 | 2.20 | 3.30 | 4.46 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 6.00 |
| 分派比率 (%) | 45.5% | 45.5% | 40.5% | 40.2% | 45.9% | 51.3% | 51.3% | 42.5% | 45.3% | 50.6% | 49.0% | 40.0% |
| 現金及約當現金 * | 4,084 | 8,756 | 10,016 | 23,482 | 31,572 | 30,241 | 33,296 | 49,154 | 43,071 | 46,775 | 35,179 | 57,599 |
| 不動產、廠房及設備 | 27,097 | 26,637 | 27,843 | 30,073 | 32,074 | 32,262 | 36,681 | 41,913 | 46,243 | 68,177 | 86,073 | 104,814 |
| 資本額 | 6,699 | 7,034 | 7,386 | 7,386 | 8,047 | 8,047 | 8,047 | 8,047 | 9,022 | 9,470 | 9,470 | 9,470 |
| 股東權益報酬率 (%) | 15.34% | 21.27% | 23.77% | 23.33% | 20.82% | 8.59% | 14.49% | 17.30% | 14.72% | 11.84% | 12.59% | 16.67% |
| 負債比率 (%) | 67.03% | 66.28% | 64.06% | 62.54% | 53.70% | 59.72% | 55.33% | 44.25% | 35.41% | 42.56% | 42.01% | 42.87% |

* 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等

臻鼎科技控股
Zhen Ding Tech. Holding

# IC載板營運規劃與執行

李定轉 董事

# IC載板營運概況

1. **上半年落底，下半年逐步回溫：**

   此波市場下修主因於客戶高庫存，不過ABF市場在部份應用上仍銷售暢旺，例如: AI, HPC等，整體應在年底有望觸底回升。

2. **反映產業供需情形，IC載板產業發展將較原先預期遞延1.5年：**

   整個半導體產業中長期依舊看好，領先廠商如台積電及英特爾，仍持續擴廠。
   IC載板方面，中低階產品新進供應商多，且產能多集中於中國大陸，缺乏國際客戶開拓能力及經驗；中高階產品短期雖有波動，中長期仍有望供不應求。

3. **陸續通過國際客戶認證：**

   半導體產業多為國際型客戶，公司陸續取得國際客戶認證，舉凡美系、歐系及日系客戶皆有佈局，客戶對公司新廠高度認可。

4. **聚焦持續開發高密度、細線路產品：**

   - ABF載板方面，已開始與客戶開發Chiplet使用之高階載板。現出貨18~20層單顆最大尺寸92mm x 92mm產品，僅6個月良率已提升至ABF載板tier 1 供應商水準。未來將進階至20L以上，單顆尺寸100mm x 100mm以上 。
   - BT載板方面，佈局ETS細線路6/8um，亦為業界tier 1領先水準。

# AI應用-Chiplet 小晶片載板

## AI

高速運算 | 資料傳輸

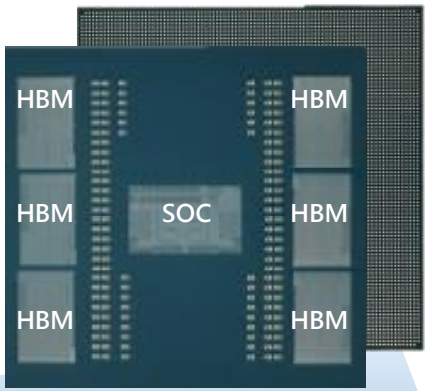
AI應用除需高速運算功能，
還需搭配快速讀寫記憶體空間

## 晶片解決方案

單一SOC
(System on Chip)
晶片面積加大
製程複雜，成本極高

**Chiplet**
小晶片集成封裝
各司其職，效率提升

## 小晶片載板




| | 載板需求技術 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 高層數 | 大尺寸 | 微孔 | 細線路 | 銅面處理技術 |
| 臻鼎 IC載板 | ✓ 18~20層 | ✓ 90x90 ~ 95x95mm | ✓ 40 ~ 60 um | ✓ 9~15 um | ✓ 低粗糙度，高結合力 |

# ABF良率已與Tier 1業者相當

秦皇島BT載板工廠：FC-CSP/WB-CSP/Memory

深圳 ABF載板工廠：FCBGA

# IC載板產能規劃

| | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
| 深圳 ABF載板 (兩廠樓地板面積共17萬平米) | Fab 1 (中高階產品) | 裝機 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 樣品認證 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 量產，目標良率與tier 1競爭對手相當 | | | | | | | | | | | 產能滿載，目標良率與tier 1競爭對手相當 | | | | |
| | Fab 2 (高階產品) | | | | | | | | | 裝機 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 樣品認證 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 量產 | | | |
| 秦皇島 BT載板 (兩廠樓地板面積共6萬平米 ) | Fab 1 | 品質領先業界 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fab 2 | 量產 | | | | 產能利用率60%+ | | 產能利用率80%+ | | | | | | | | | |

# IC載板營運目標

**NT$600億**

**IC載板資本支出：**

2022-2027規劃投資600億

**>50%**

**IC載板營收：**

2023-2027複合成長率 > 50%

**15%+/-**

**IC載板營收：**

至2027年，IC載板占臻鼎合併營收15%+/-

**前5大**

**IC載板市占率：**

目標2030年成為IC載板全球前五大

臻鼎科技控股
Zhen Ding Tech. Holding

# 策略布局

沈慶芳 董事長兼總經理

# 1H23回顧與營運展望

1 **上半年營運面臨逆風，專注產品開發與營運效率優化：**

受到消費性電子需求不振，及客戶新舊產品轉換期影響，臻鼎營收隨產業趨勢呈現年減。然而於此期間，公司專注產品開發與營運效率優化，具體效益包含行動通訊產品毛利率在上半年不景氣之中仍實現年增。

2 **穩守客戶新品市占率，持續投入研發，協同客戶共同開發新應用市場：**

逆境之中，臻鼎持續與世界一流客戶長期合作，穩守客戶每一代新品主要供應商角色。此外，臻鼎持續投入研發，發展多元應用市場，在伺服器(包含AI伺服器)和汽車領域擁有產品與技術儲備，掌握產業升級趨勢。

3 **分階段提升各廠智能管理，提升內部營運效率：**

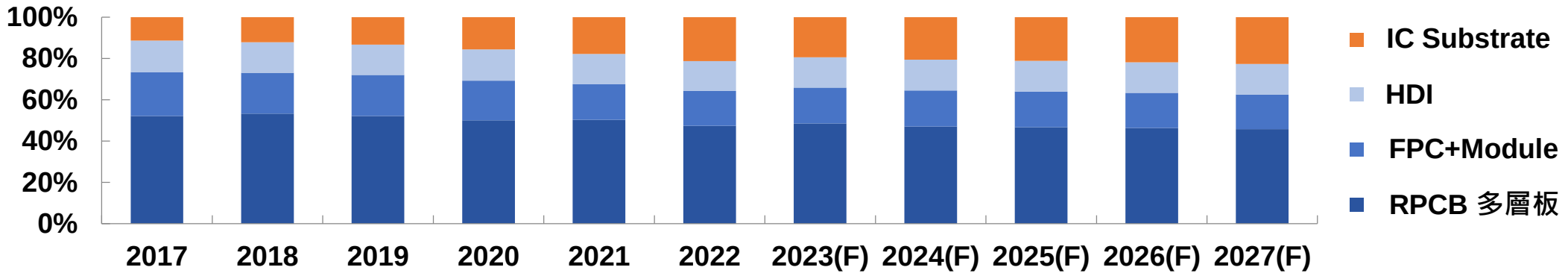
在One ZDT 策略下，各廠區分階段導入智能管理，目前淮安第三園區新廠已是導入智能管理的第九座工廠，不斷提升整體營運效率。

4 **持續看好中長期IC載板需求：**

短期而言，BT載板需求已於第一季落底並逐步回溫中，ABF載板仍待客戶庫存調整，在此期間臻鼎致力快速拉升新廠良率與效率，目前良率已與Tier 1 業者相當。臻鼎持續看好IC載板產業中長期趨勢，5G、AI伺服器、車用電子等高速運算需求將帶動ABF載板未來成長，未來三年在營收與獲利貢獻將有顯著提升。

5 **為符合大陸資本運作規範，按既定組織規劃，李定轉總經理將轉任禮鼎董事長兼總經理。同時為符合公司治理要求，臻鼎增設一名獨立董事，由原本3席增至4席獨立董事。**

# 各類PCB市場規模預期明年重回成長軌道




單位：百萬美元

| 產品 | 項目 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(F) | 2024(F) | 2025(F) | 2026(F) | 2027(F) | 2022-2027 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCB | 產值 | 30,656 | 33,225 | 31,969 | 32,674 | 40,641 | 38,720 | 35,968 | 36,779 | 39,564 | 42,407 | 45,048 | 3.1% |
| | 佔全球比 | 52.1% | 53.2% | 52.1% | 50.1% | 50.2% | 47.4% | 48.5% | 47.0% | 46.7% | 46.4% | 45.8% | |
| FPC | 產值 | 12,523 | 12,395 | 12,195 | 12,483 | 14,058 | 13,842 | 12,843 | 13,668 | 14,545 | 15,479 | 16,473 | 3.5% |
| | 佔全球比 | 21.3% | 19.9% | 19.9% | 19.1% | 17.4% | 16.9% | 17.3% | 17.5% | 17.2% | 16.9% | 16.7% | |
| HDI | 產值 | 8,968 | 9,222 | 9,008 | 9,874 | 11,811 | 11,763 | 10,892 | 11,716 | 12,602 | 13,556 | 14,581 | 4.4% |
| | 佔全球比 | 15.2% | 14.8% | 14.7% | 15.1% | 14.6% | 14.4% | 14.7% | 15.0% | 14.9% | 14.8% | 14.8% | |
| ICS | 產值 | 6,696 | 7,554 | 8,139 | 10,188 | 14,410 | 17,415 | 14,436 | 16,091 | 17,937 | 19,993 | 22,286 | 5.1% |
| | 佔全球比 | 11.4% | 12.1% | 13.3% | 15.6% | 17.8% | 21.3% | 19.5% | 20.6% | 21.2% | 21.9% | 22.7% | |
| 合計 | | 58,843 | 62,396 | 61,311 | 65,219 | 80,920 | 81,740 | 74,139 | 78,254 | 84,648 | 91,435 | 98,388 | 3.8% |
| 年增率 | | 8.6% | 6.0% | -1.7% | 6.4% | 24.1% | 1.0% | -9.3% | 5.6% | 8.2% | 8.0% | 7.6% | |

資料來源：Prismark (2023/5)；2024~2026年係用Prismark數據推估。

# 全球5大主要生產基地

## 多廠區生產基地，貼近客戶需求

### 中國大陸 秦皇島

**秦皇島園區**
(FPC與先進模組/SLP高階 HDI)

**BT載板園區**
**(第一期2022年量產)**

### 中國大陸 淮安

**淮安第一園區**
(RPCB/HDI)

**淮安第二園區**
(FPC與先進模組/HDI/Mini LED 背光超薄細線路電路板)

**淮安第三園區**
(高階 HDI/MSAP)
**(預計2023年量產)**

### 印度

**清奈園區**
(FPC先進模組)

### 中國大陸 深圳

**深圳第一園區**
(FPC與先進模組/HDI)

**深圳第二園區**
(FPC先進模組)

**ABF載板園區**
**(第一期2023年量產)**

### 台灣

**高雄園區**
(FPC與先進模組)
**(預計2024年量產)**

**桃園 先豐通訊園區**
(網通、高速運算、汽車等相關領域之印刷電路板)

# 臻鼎計畫於泰國增設新廠

地點：泰國巴真府

臻鼎科技集團 Zhen Ding Tech. Group

SAHA GROUP

## 與當地夥伴策略合作

- 因應客戶需求，完善公司全球化布局戰略。
- 擬選址泰國巴真府。
- 第一期投資金額2.5億美金。
- 預計2025年上半年試生產。

# 致力推動EPS + ESG，國際ESG評比持續提升

## ESG評鑑結果

### ▸ 臺灣公司治理評鑑

2023年公司治理評鑑排名上市公司6%-20%，再度**入選臺灣證券交易所公司治理100指數**。

### ▸ 晨星Sustainalytics ESG 風險評級

2023年Sustainalytics ESG風險評級由17.8進步至15.6，為**低等風險等級**。

### ▸ 標普全球企業永續評鑑 S&P Global ESG

2022年S&P Global ESG 評級進步至71分，**入選標普全球永續年鑑** (Sustainability Yearbook)。

### ▸ 富時羅素 FTSE Russell ESG

2022年12月FTSE Russell ESG評級由3.6分進步至4.3分（滿分為5分），成為**台灣上市櫃公司並列第三名**。

## ESG亮點績效

### ▸ 溫室氣體排放與能源管理

2022年單位營收溫室氣體排放（範疇一及範疇二）較2013年**減少35%**。

2022年再生能源使用量較前一年**增加16倍**。

### ▸ 水資源管理

2022年單位營收用水量較2013年**減少40%**。

2022年廢水回用率達**50.5%**。

### ▸ 循環經濟與綠色採購

積極與供應商與客戶共同推動回收金屬的使用。回收錫膏之使用率達**90%**，金鹽的回收數量已達金鹽使用量的**42%**。

### ▸ 董事會結構

2023年董事改選後，獨立董事佔比達**57%**，女性董事佔比**14%**。

# Q&A

臻鼎科技控股
Zhen Ding Tech. Holding

THANK YOU